

РЕФЕРАТ

Работа выполнена на 32 страницах печатного текста. Содержит 1 таблицы, 15 рисунков. Для теоретического обоснования привлечено 23 литературных источников.

Объект исследований: тонкие пленки W / Cu, полученные методом электронно-лучевого испарения.

Предмет исследований: влияние отжига на структурный и фазовый состав тонких пленок W / Cu.

Цель исследований: исследовать и описать структурно-фазные преобразования термообработанных тонкопленочных структур W / Cu при различных температурах отжига.

Методы исследований: электронная микроскопия, электронография (ЭМР-100).

Результаты исследований: с помощью просвечивающей электронной микроскопии выполнен анализ термообработанной пленки W / Cu. Проведя расчеты микроэлектронограм W / Cu до и после термообработки было обнаружено увеличение размера зерна, что указывает на то, что происходят зернограницные фазовые превращения.

Сфера применения: электроника, химическая промышленность, медицина.

ТОНКАЯ ПЛЕНКА, ИССЛЕДОВАНИЯ, ВОЛЬФРАМ, МЕДЬ, СРЕДА,
ОТЖИГ, МИКРОЭЛЕКТРОНОГРАММА, ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ,
ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ